



tsmc 全球研發中心啟用 深化半導體高階技術扎根台灣

Global R&D Center of TSMC Started Operation, High-end Semiconductor Technology Innovation Is Taking Root in Taiwan

tsmc グローバル研究開発センターオープン、先進半導体技術の開発が台湾に留まる

文・圖／投資組 李孝丞、沈氏藝術印刷特約攝影 陳秉均



右4至左3依序，國科會吳政忠主委、台積劉德音董事長、台積創辦人張忠謀先生、行政院陳建仁院長、台積魏哲家總裁、經濟部王美花部長、新竹縣楊文科縣長

台灣積體電路製造股份有限公司 (tsmc) 於 2023 年 7 月 28 日在新竹科學園區舉行全球研發中心落成典禮，由台積公司劉德音董事長、魏哲家總裁主持，台積公司創辦人張忠謀先生、行政院陳建仁院長、國科會吳政忠主委、經濟部王美花部長、新竹縣楊文科縣長、科管局王永壯局長及各界貴賓應邀出席祝賀，場面熱鬧而隆重。

台積公司在 2022 年底宣布 3 奈米進入量產，締造半導體先進製程的重要里程碑，於 2023 年 6 月則宣布其先進封測六廠正式啟用，實現 3DFabric™ 整合前段 3D 矽堆疊與後段先進封裝技術的目標，達成封裝技術突破；而本次於新竹園區啟用的研發中心及建造中的 12 吋先進製程量產廠房，後續預計將有超過 8,000 名研發人員進駐，投入推動 3 奈米暨以下的半導體晶片先進製程技術研發，該項技術現為該公司及全球最先進半導體晶片製程。

台積全球研發中心座落於半導體產業群聚的竹科新竹園區，擁有晶圓代工、設計、光罩、封裝及測試等完整垂直分工體系，且鄰近清大、陽明交大與工研院等學研機構，有利產、官、學、研各方資源挹注，該研發中心的啟用，預計將再次強化半導體的先進製程及封裝技術發展量能，進一步深化半導體產業高階技術及研發扎根臺灣，並與竹科的創新能量和群聚效應相互結合，鞏固臺灣作為全球半導體核心的領先優勢。

新竹科學園區為我國科技核心樞紐，由於持續不斷引進國內外旗艦級創新公司進駐發展下，半導體產業上下游生態系完整且聚落效應強勁，2022 年營業額及出口額較前一年分別成長 1.59% 及 8.52%，達新臺幣 16,132.55 億元及 17,292.82 億元，進口額成長 29.53%，達新臺幣 8,356.85 億元，可見竹科高科技產業重鎮地位，並已成為全球相關產業共創共榮的關鍵夥伴。